附件：

会议日程安排

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 牵头单位 | 备注 | 会议ID |
|  | 国标委发[2020]53号  20204891-T-469 | 硅片表面光泽度的测试方法 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | 预审 | 450-883-812 |
|  | 国标委发[2020]48号  20203728-T-469 | 碳化硅外延片表面缺陷的测试 显微可见光法 | 芜湖启迪半导体有限公司 | 预审 |
|  | 国标委发[2020]53号  20204893-T-469 | 碳化硅外延层厚度的测试 红外反射法 | 芜湖启迪半导体有限公司 | 预审 |
|  | 国标委发[2021]12号  20210892-T-469 | 硅片流动图形缺陷的检测 腐蚀法 | 徐州鑫晶半导体科技有限公司 | 预审 |
|  | 中色协科字[2021]88号  2021-020-T/CNIA | 硅片切割废料回收硅 | 中国科学院过程工程研究所 | 讨论 |